

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2026-016

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心，对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站披露了《江苏宏微科技股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”），自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，现将“2025 年行动方案的实施进展及评估情况”和“2026 年主要措施”报告如下：

一、聚焦公司主营业务，夯实高质量发展根基

公司是国内功率半导体领域的领军企业，自成立以来，始终专注于以 IGBT、FRD、SiC、GaN 为核心的功率半导体芯片、单管及模块的设计、研发、生产与销售。依托第三代半导体材料与工艺创新，公司在超微沟槽结构+场阻断技术、续流用软恢复二极管芯片技术、模块塑封技术等领域形成独特技术壁垒，自主研发的第七代功率芯片已实现关键性能指标对标国际先进水平。公司产品全面覆盖新能源汽车（电控系统、充电桩和 OBC 电源）、新能源发电（光伏逆变器、风能变流器和电能质量管理）、储能、工业控制（变频器、伺服电机、UPS 及各种开关电源等）、家电消费等领域，产品性能与工艺技术处于行业先进水平。

2025 年度，公司所处的功率半导体行业景气度回升。全球智算投资持续加码，新能源发电、工业控制、AI 服务器电源等领域对新型电力电子装置的需求

加速迭代。公司把握市场机遇，持续丰富 IGBT、MOSFET、FRD 及 SiC、GaN 产品组合，扩大业务外延，丰富客户结构，根据客户需求提供定制化的功率器件解决方案，带动了整体盈利能力提升。

2026 年是高质量巩固的关键之年，公司管理团队将在董事会的领导下，围绕发展战略，为实现既定经营目标努力。2026 年公司将以“提升产品竞争力、打造柔性供应链、巩固质量品牌力、抢占市场制高点”的工作方针，持续开发具有高护城河、高技术浓度、高性价比的功率器件产品，降本增效，保障高质量完成年度经营目标。公司将从以下方面优化业务管理工作：

（一）深耕主业经营提质，实现高质量发展

2025 年，公司通过技术创新、工艺改进和精细化管理，提高了生产效率和产品的良品率。通过加强上下游协同，深化产业链战略合作，核心竞争力持续提升。报告期内，公司实现营业收入 134,770.66 万元，归属于上市公司股东净利润 1,711.49 万元，同比分别增长 1.23%和 218.30%，经营业绩同比实现扭亏为盈。

2026 年，公司管理团队将在董事会的领导下，围绕发展战略，为实现既定经营目标努力。公司将全面贯彻“一体两翼”战略，在巩固现有硅基器件主航道优势的同时，加速渗透 SiC 和 GaN 为代表的第三代半导体高性能功率模块在多场景中的规模化应用，重点布局 AIDC、人形机器人、低空经济、可控核聚变、智能电网等成长性领域，持续深化技术研发与客户合作，提升产品的核心竞争力，力争在新兴赛道构建先发优势，为公司的可持续发展蓄力护航。

1、深化多领域市场布局，加速新兴产业突破

持续深化新能源汽车、光伏储能、工业控制三大核心市场布局，加速向 AIDC、人形机器人、低空经济、可控核聚变、智能电网等新兴产业场景渗透；依托自研 IGBT、SiC、GaN 芯片及模块一体化技术优势，加快第三代半导体产品的客户验证与批量交付，进一步拓展头部车企、新能源发电、数据中心等高端供应链份额，构建覆盖传统优势赛道与前沿新兴领域的全场景市场体系，夯实功率半导体国产替代核心竞争力。

2、聚焦核心技术攻关，筑牢技术壁垒

针对新能源汽车与新能源发电领域的 Si 基器件，加大研发投入，深入开展标准化和定制化产品研发；利用高电流密度 IGBT 芯片和先进封装技术进一步提升公司在工业控制、新能源发电、储能、新能源汽车、数据中心等领域产品的性能、一致性及稳定性；聚焦第三代半导体材料（如 SiC、GaN）在功率半导体器件领域的设计研发与应用拓展，加快第三代半导体 SiC SBD 和 SiC MOSFET 芯片开发及量产。

3、完善人才招引与人才培养制度，推行价值循环机制

公司秉承“以人为本”的核心理念，注重优秀人才的引进和培养，加大人才资金投入并建立有效的激励机制。一方面，公司将继续深化员工再培训体系，加速培育一批综合素质过硬、业务能力精湛的芯片及模块设计人才、管理人才；另一方面，公司将积极拓宽引才渠道，加大外部人才的引进力度，尤其是国内外的行业技术专家、管理经验杰出的高端人才等，保持核心人才的竞争力。通过建立多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工的忠诚度与价值认同感。

4、深化战略客户合作，拓宽高端市场布局

聚焦公司战略核心客户开展深度需求研判与场景化分析，精准打造新型功率半导体器件及模块的定制化专属解决方案。深度挖掘与行业头部龙头企业的协同合作潜力，常态化开展技术对接、联合研发与需求研讨，持续迭代优化产品核心性能，健全全流程服务保障体系，精准匹配客户持续升级的高端应用需求。

在稳固深化战略大客户合作根基的同时，积极拓展优质中小客户资源，搭建高效协同的需求响应与沟通对接机制。针对中小客户需求多元化、订单多批次、小批量的经营特点，持续优化生产管控与供应链协同管理体系，落地升级柔性智能制造产能，快速落地个性化定制交付服务，全面提升客户合作满意度与长期粘性。

5、持续推进质量管理体系建设

2025 年，是质量提升之年，公司围绕“提升宏微质量品牌，降低不良质量成本，优化客户质量服务”的主题，在研发质量、供应商质量、客户质量服务等方面

面开展了一系列的改善活动，强化质量管理体系建设；扩大统计过程控制的涵盖项目，对成品测试进行统计良率管控，严控制造过程波动；提高可靠性监控频次和覆盖面，确保出货产品的高可靠性；加强供应商管理，制定物料质量要求，推行“三化一稳定，严进严出”理念，对重点物料安排驻厂督造，从源头保障供应链质量。2025年，公司IGBT模块整体良率提升1%，市场端失效率降低28.20%。公司的整体质量表现获得国内外头部客户的一致认可。

2026年，公司以“提升产品竞争力，打造柔性供应链，巩固质量品牌力，抢占市场制高点”为方针，在车规、光伏、工控三大领域与关键客户合作进行质量改善专项，提升质量管理能力。同时持续提升“三化一稳定”，利用AI工具赋能质量知识管理和在线检验，提升质量管理效能，形成防呆防错机制。加强对重要供应商和二级供应商的管理和赋能，确保物料质量，以最终保障公司产品性能的一致性、质量的稳定性和全生命周期的可靠性，巩固公司产品在客户端的质量品牌，继续提高公司的核心竞争力。

6、数智赋能打造高效敏捷的柔性供应链体系

聚焦柔性供应链体系建设，全面强化供应链整体统筹与顶层策划，搭建流程驱动、体系支撑的一体化运营架构，持续优化供应链全域布局，大幅提升多变采购需求下的敏捷响应与适配能力；加快采购业务信息化转型升级，深化前端协同联动与采购策略深耕，常态化推行竞争性采购模式，稳固产品交付保障能力。同时，以数字化深度赋能全链路管理，依托IT系统打通订单、生产、库存、物流信息壁垒，实现需求精准预判与资源动态调配；推进产品平台化研发、生产模块化落地，压缩产线换线周期，精进生产节拍精细化管控，并深化上下游战略合作，联动核心供应商、重点客户及物流伙伴搭建库存动态补给机制，有效压降库存压力，筑牢协同共赢、高效稳健的供应链核心优势。

7、积极践行 ESG 发展理念，谱写可持续发展新篇章

2025年，公司首次编制发布《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》，系统呈现可持续发展实践成果与责任担当。凭借在环境管理、社会责任、公司治理领域的扎实积累，公司斩获Wind ESG“A”类、秩鼎 ESG“AA”类、中诚信“A-”类等权威评级，可持续发展能力获资本市场与专业领域双重认可。公司始终将

ESG 理念融入战略规划、经营管理与企业文化，构建利益相关方共赢的可持续发展生态。通过与客户、员工、供应商、社区等协同协作，在绿色生产、责任践行、治理优化等维度持续发力，形成商业价值与社会价值共生的可持续商业模式。

2026 年，公司将坚守“绿色、低碳、可持续”发展承诺，立足产业优势夯实 ESG 管理基础，深化业务与可持续发展理念的融合创新，发挥行业引领作用，赋能产业链协同发展，持续书写企业与社会、环境和谐共生的新篇章。

（二）深耕战略合作赋能前沿突破，聚力产业链协同激活增长动能

2025 年，公司立足功率半导体核心主业，以“技术协同、产业联动、成果转化”为核心，通过签署战略合作协议、搭建联合攻关平台等新模式，深度链接产业链上下游优质资源，聚焦前沿领域与关键技术突破，推动新技术与新产业深度融合，培育新业态，拓展发展新空间。具体情况如下：

1、布局可控核聚变前沿领域，抢占未来能源技术制高点

公司与瀚海聚能签署战略合作协议，双方聚焦可控核聚变前沿领域，联合攻关聚变装置（重点围绕 FRC 技术路径）所需高性能、高可靠性功率半导体开关核心技术。依托公司成熟完备的 IGBT 产业化积淀，融合瀚海聚能在 FRC 装置研发领域的创新经验，合力突破聚变电源系统关键技术瓶颈。本次合作是公司紧扣国家核聚变未来能源战略的前瞻性布局，为搭建自主可控的聚变产业链筑牢核心器件支撑，助力加快实现“人造太阳”能源愿景。

2、深化 SiC 技术协同，推动第三代半导体国产化落地

公司与北京怀柔实验室达成碳化硅技术及成果转化战略合作，聚焦 SiC 芯片、器件及模块在国家能源关键领域的落地应用，全力推进第三代半导体国产化、自主化进程。双方计划依托产业转化合资平台，攻坚高压大电流 SiC 芯片设计、制造工艺、高可靠性封装等核心关键技术，加速产品在新能源基地、柔性输配电等国家级重大工程中的示范应用，推动前沿技术创新与规模化量产深度融合，全面提升国产高端功率器件的市场核心竞争力。

3、聚焦人形机器人等新兴赛道，拓展产业应用新场景

公司携手国内传动领域控制设备与系统集成龙头企业签订战略合作协议，聚

焦电控系统、液压控制系统、伺服系统及人形机器人核心零部件（执行器、电动缸、控制器）配套功率半导体器件研发，重点围绕 GaN 产品开展联合研发与技术共创。此次合作具备重要战略导向意义，将助力公司 GaN 系列产品快速切入工控、液压、伺服、机器人等优质赛道，深度拓宽新兴市场版图，精准契合企业长期战略发展规划。

4、深化制造端协同合作，强化功率半导体主业根基

公司与华虹宏力签署五年期《战略合作谅解备忘录》，双方聚焦 IGBT、FRD 等核心产品领域深化协作，通过联合组建研发项目组，集中力量推进技术创新与平台优化，这一深度合作将直接推动公司 IGBT、SiC MOSFET 等产品性能对标国际先进水平，为国产功率半导体器件突破国际技术壁垒提供核心动能。该战略举措显著强化了公司以设计与模块封装为核心的“虚拟 IDM”模式竞争力，既规避了 IDM 模式（垂直整合制造模式）的资本重负，又通过绑定顶尖代工厂的专项工艺支持获得类似垂直整合的协同效应。这一制造端战略支点的确立，不仅夯实了公司作为国内功率半导体设计及模块解决方案龙头的主导地位，更通过技术、产能、成本的多维跃升，为其跻身国际一线功率半导体供应商梯队提供了可落地的跳板，标志着中国功率半导体产业从单点突破迈向全链条高端化的关键跨越。

2026 年，公司将持续深化全产业链战略布局，充分发挥自身技术研发优势与市场资源积淀，持续拓展新兴业务领域、挖掘产业增长空间，深耕功率半导体核心主业，赋能国内半导体产业高质量升级，全力书写行业创新发展全新篇章。

（三）增强创新驱动动力，培育新质生产力

2025 年，公司研发投入 11,535.77 万元，占营业收入的 8.56%，公司在加大核心技术开发的同时，加快技术创新和产品升级。经过十几年的技术沉淀和积累，公司已在 IGBT、FRD、SiC、GaN 等功率半导体芯片、单管和模块的设计、封装和测试等方面积累了众多核心技术。其中芯片领域的核心技术主要包括沟槽栅+场阻断、虚拟原胞、逆导集成结构等 IGBT 芯片设计及制造技术；软恢复结构、非均匀少子寿命控制技术等 FRD 芯片设计及制造技术；高可靠终端设计等高压 MOSFET 芯片设计及制造技术等。在模块封装领域的核心技术主要包括低分布参数的模块布线技术、无压和有压银烧结技术、端子超声键合技术、基于平面传

递模塑封 PTM 的双面/单面水冷技术等。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已取得发明专利 52 项，实用新型专利 84 项，核心知识产权布局持续夯实，自主创新能力稳步提升。公司自成立以来，始终聚焦 IGBT、FRD 为主的功率半导体芯片、单管和模块的设计、研发、生产和销售，依托自研芯片与先进封装工艺的优势，为客户提供功率半导体器件的解决方案，助力下游客户实现高效节能、高可靠的电力电子应用，持续打破国外技术垄断、填补国内高端功率器件领域多项空白，是国内中高压 IGBT 及功率模块领域的领军企业之一。

2026 年，研发规划将围绕第三代半导体深化布局、车规级产品迭代、封装技术创新、应用场景拓展及产业链协同等方向展开。公司将继续加大研发投入，重点投向 SiC 和 GaN 技术，推进制造工艺改善，同时加速 SiC MOSFET 产品落地，以匹配 800V 电动汽车平台及光伏储能 1500V 高压系统需求。

（四）强化研发人才团队建设

截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员合计 220 人，其中包括 43 名硕士、3 名博士，多名研发人员拥有功率半导体芯片设计和模块封装等方面的学术及研发经验，并已在行业深耕多年，对行业研发方向有深刻的把控；在功率半导体芯片设计和模块封装领域积累了丰富的技术研发经验，保证了公司产品和技术的不创新。

公司持续优化人才培养体系，依托健全管理制度深耕创新文化建设，聚焦员工与企业协同发展，以优质工作环境、清晰成长路径与广阔发展机遇精准引才、用心留才、科学育才；一方面坚持引育并举，加大人才专项投入并搭建高效激励机制，为企业战略落地与目标达成筑牢人才支撑，另一方面常态化开展员工赋能培训，精准培育高素质、强专业的芯片及模块设计技术人才与复合型管理人才，同时强化外部高端人才引进，重点吸纳行业技术专家与资深优质管理人才，持续巩固核心人才竞争优势，此外通过构建多层次长效激励体系，充分激发员工积极性与创新创造力，全面提升员工归属感、认同感与忠诚度，凝聚企业高质量发展的内生动力。

2026 年，公司将持续加大研发的高投入，不断提升创新能力。将继续高度

重视研发团队的建设，不断丰富核心团队和技术人员梯队，同时通过培训和学习计划提升现有员工的技术水平，优化人才激励机制，以激励研发人员积极参与创新活动并分享研发成果；加强专利申请保护，完善专利管理制度，保护公司合法权益。

（五）强化募投项目规范运作，赋能公司长效发展

公司首次公开发行股票募投项目“新型电力半导体器件产业基地项目”与“研发中心建设项目”已于 2023 年 12 月实施完毕并达到预定可使用状态。在此基础上，公司紧抓行业国产化替代战略机遇，持续深化募投成果转化；稳步推进产能规划项目实施落地，依托精益化管理实现降本增效，同步引进先进生产工艺与核心设备，持续优化产能结构、提升产能利用率，进一步夯实产业发展根基。

2023 年 7 月 25 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券，本次募集资金净额为 42,327.69 万元，该资金全部用于车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期），本次募投项目的实施将使公司在前次募投项目实施的基础上，进一步提升车规级功率半导体器件产能，扩大公司在新能源汽车领域的布局，推动公司长期可持续发展。

2026 年，公司将稳步推进募投项目建设实施，严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，坚持专款专用、审慎管控，确保募集资金合规规范、高效集约使用；同时系统化统筹项目建设全流程，保障各环节按计划有序推进，科学优化资金配置与投向安排，全力推动募投项目尽早投产达效，进一步夯实主营业务核心竞争力，持续增厚经营业绩，全面提升公司整体盈利水平与长期可持续发展能力。

二、牢固树立回报股东意识，共享公司价值成长红利

公司将统筹平衡经营发展、业绩增长与股东回报，构建长期稳健、可持续的价值回馈机制，扎实落地提质增效重回报相关举措，让股东充分共享企业发展成果，积极助力稳定市场预期、提振投资信心。兼顾长远稳健经营的前提下，公司利润分配始终保持连续性与稳定性，自 2021 年上市以来，公司已累计派发含税现金红利 4,249.17 万元（含税），坚持以常态化分红共享企业成长红利。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，公司于 2024 年 8 月完成第一期股份回购，第一期已回购股份 159.80 万股，回购金额为 2,549.62 万元（不含交易费用）；并于 2025 年 12 月完成第二期股份回购，截至 2025 年 3 月末，第二期已回购股份 139.11 万股，回购金额为 2,502.98 万元（不含交易费用）。

2026 年，公司将兼顾业务拓展与资金储备需求，持续优化利润分配方案，稳步落实股东回馈举措，携手全体股东共享企业成长红利。公司将结合实际经营成效与中长期发展规划，动态统筹经营发展、业绩增长与股东回报的平衡关系，坚守长期稳健、可持续的分红回报机制，积极探索多元化分红及常态化多次分红路径，力争在实现业绩稳步增长的同时，持续向广大股东释放发展收益，充分共享企业经营成果。

三、深化投资者沟通交流，健全长效市值管理

公司始终高度重视维护中小投资者的合法权益，保障中小投资者的参与权、知情权，致力于与投资者建立和谐、畅通、合规、高效的沟通机制，加强公司与投资者之间的理解与信任。

公司董事会办公室为公司与投资者沟通的专职部门，自上市以来，公司设置专人接听投资者专线（0519-85163738），积极回复投资者邮箱（xxpl@macmicst.com）以及“上证 e 互动”平台，在定期报告披露后，在“上证路演中心”等平台举办投资者交流会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读。公司严格遵循法律法规和监管要求，执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

为进一步规范市值管理相关运作、切实保障投资者及各类利益相关方的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中鼓励上市公司建立完善市值管理制度的政策号召，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关法律法规要求，公司于 2025 年 7 月完成修订《江苏宏微科技股份有限公司市值管理制度》，全面

夯实公司市值管理规范、制度化、常态化运营根基。

四、完善公司治理，推动公司高质量发展

规范运作是上市公司行稳致远的有力保障，有助于降低公司经营风险，为投资者提供公开、真实、透明的上市公司，公司始终牢牢把握合规底线，将合规理念融入公司治理之中。

（一）持续完善治理结构，助力公司规范运作

2025年，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，积极推进取消监事会及修订管理制度的相关工作，共修订管理制度33项，废止管理制度1项，制定管理制度1项，进一步完善公司治理结构，建立健全管理机制，确保审计委员会顺利承接监事会职权，维护公司治理结构由“三会一层”向“两会一层”平稳过渡，全面提升治理效能与监督专业化水平。

2026年，公司将积极参加各类监管机构例如中国证券监督管理委员会江苏监管局、上海证券交易所及其下属机构组织的线上、线下培训交流活动，踊跃报名各协会组织举办的资本市场交流活动，保持与市场的良好连接，并向优秀的上市公司学习、借鉴经验，助力公司董事、高管治理能力的提升。公司将持续加强公司内部培训，通过学习了解最新的法律法规知识、关注理解监管动态等方式，不断强化其合规意识，提升公司董事、高管及管理层的履职能力。

（二）为独立董事履职提供便利，切实发挥独董作用

公司将深入贯彻落实独立董事制度改革的要求，为独立董事履职提供便利条件。公司董事会办公室作为与独董沟通的服务部门，将及时准备会议所需材料及独董要求查阅的资料并做好信息反馈工作；公司管理层将及时向独立董事汇报公司经营情况和重大事项，更充分地发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司持续规范发展，保护广大投资者合法权益。

（三）夯实 ESG 管理水平，实现可持续发展

公司高度重视 ESG 管理体系的建设工作，建立了自上而下的 ESG 管理架构，通过董事会战略委员会下设 ESG 领导小组、ESG 执行小组的 ESG 治理机制，推

动落实公司在环境保护、员工权益、公司治理等方面的 ESG 工作。公司积极践行“绿色、低碳、可持续”的发展理念，基于自身产业特点，进一步夯实整合业务基础，高效赋能行业可持续发展。

2026 年，公司将继续提升 ESG 相关绩效，不断创新研发，坚持以人为本和绿色发展理念，加强内部控制管理，积极与各利益相关方沟通，进一步提升 ESG 管理水平。

五、强化“关键少数”责任，激励与约束共进退，提高履职能力

（一）强化“关键少数”责任

上市以来，公司持续加强与实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及董事、高级管理人员等“关键少数”的常态化沟通联动，定期组织参与交易所、证监局等监管机构开展合规培训，并围绕股份减持新规、典型违规案例等内容开展专项宣导学习，持续强化“关键少数”合规履职意识与专业履职能力。同时，动态更新关键少数人员台账，提前做好事项预沟通与流程提醒，密切跟踪相关承诺事项履行进度，确保各项承诺严格落地执行。

后续，公司将持续深化与“关键少数”的沟通协同，常态化跟踪督导承诺履约情况，不断压实主体责任、强化履约意识；持续组织资本市场法律法规与合规专业知识学习，全面提升关键少数自律风控水平，全方位保障公司稳健规范运营。

（二）激励与约束并措

2025 年，公司已完成第二期股份回购，回购股份用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，将员工的个人利益与公司的长远发展进行深度绑定，极大调动了员工的积极性和主人翁意识，有效增强了团队的稳定性和归属感。同时，公司为高级管理人员制定了与公司经营情况相挂钩的薪酬政策，根据高级管理人员岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度确定报酬，即：年薪=基本薪酬+绩效奖金+长期激励，其中绩效奖金与公司及个人绩效结构挂钩。

为进一步构建更为科学、长效的激励机制，实现公司战略规划和经营目标，持续提升公司的综合竞争实力，充分调动核心员工的工作积极性和创造力，公司

于 2025 年 4 月发布《2025 年限制性股票激励计划（草案）》，对部分董事、高级管理人员、核心技术人员与核心员工实施激励。2025 年 6 月，公司以 9.35 元/股的授予价格，向 116 名激励对象首次授予 232.86 万股限制性股票。目前，公司正紧扣股权激励考核目标稳步推进经营管理各项工作，赋能企业长远高质量发展。

2026 年，公司将继续加强公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”与公司中小股东的风险共担及利益共享约束，强化“关键少数”人员合规意识，优化并持续执行高管薪酬方案，切实推动公司高质量发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日